

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年3月2日(02.03.2023)



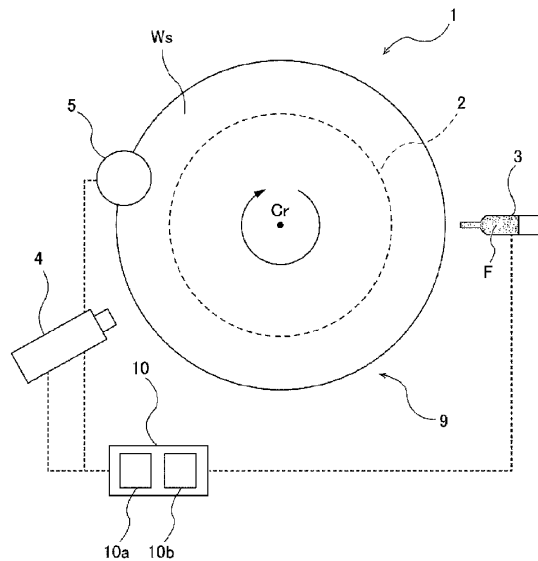
(10) 国際公開番号

WO 2023/026719 A1

- (51) 国際特許分類:
B05D 3/00 (2006.01) *B05C 9/14* (2006.01)
B05C 5/00 (2006.01) *B05D 7/00* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/027660
- (22) 国際出願日: 2022年7月14日(14.07.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-138807 2021年8月27日(27.08.2021) JP
- (71) 出願人: 株式会社荏原製作所 (EBARA CORPORATION) [JP/JP]; 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 佐竹 正行 (SATAKE, Masayuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP). 中西 正行 (NAKANISHI, Masayuki); 〒1448510 東京都大田区羽田旭町 1 1 番 1 号 株式会社荏原製作所内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 廣澤 哲也, 外 (HIROSAWA, Tetsuya et al.); 〒1600023 東京都新宿区西新宿 7 丁目 5 番 8 号 GOWA 西新宿 4 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING METHOD AND SUBSTRATE PROCESSING APPARATUS

(54) 発明の名称: 基板処理方法および基板処理装置



(57) Abstract: The present invention relates to a substrate processing method and a substrate processing apparatus with which cracking and chipping of a laminated substrate manufactured by bonding a plurality of substrates are suppressed, and more specifically to a technology for applying a filler to a gap formed between edge portions of the plurality of substrates constituting the laminated substrate. This method comprises: applying a filler (F) to a gap between an edge portion (E1) of a first substrate (W1) and an edge portion (E2) of a second substrate (W2); curing the applied filler (F);

[続葉有]



WO 2023/026719 A1

HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, KE,
KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR,
LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

generating, with an infrared imaging device (5), an image of an edge portion of a laminated substrate (Ws) to which the filler (F) has been applied; and determining the filling state of the filler (F) applied to the gap between the edge portion (E1) of the first substrate (W1) and the edge portion (E2) of the second substrate (W2) on the basis of the image.

(57) 要約: 本発明は、複数の基板を接合して製造される積層基板の割れおよび欠けを抑制する基板処理方法、および基板処理装置に関し、特に積層基板を構成する複数の基板のエッジ部間に形成された隙間に充填剤を塗布する技術に関するものである。本方法は、第1基板(W1)のエッジ部(E1)と第2基板(W2)のエッジ部(E2)との隙間に充填剤(F)を塗布し、塗布した充填剤(F)を硬化し、充填剤(F)を塗布した積層基板(Ws)のエッジ部の画像を赤外線撮像装置(5)により生成し、画像に基づいて、第1基板(W1)のエッジ部(E1)と第2基板(W2)のエッジ部(E2)との隙間に塗布された充填剤(F)の充填状態を決定する。